



P/N: STBP218-1R2-G432

### Thin Film Planar Filters

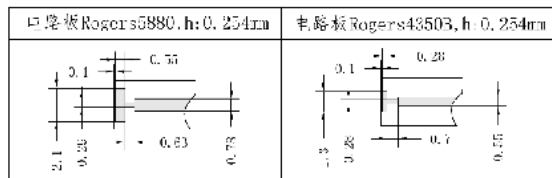
### 产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

技术要求,  $T_A = 25^\circ\text{C}$

| 参数                | 最小   | 典型   | 最大   | 单位  |
|-------------------|------|------|------|-----|
| 中心频率              |      | 21.8 |      | GHz |
| 工作频率              | 21.2 |      | 22.4 | GHz |
| 中心损耗              |      | 2.4  | 2.9  | dB  |
| 带内波动              |      | 0.5  | 1.0  | dB  |
| 回波损耗              | 12   | 15   |      | dB  |
| 带外抑制@DC-19.8GHz   | 55   | 60   |      | dBc |
| 带外抑制@24.1-31.0GHz | 55   | 60   |      | dBc |
|                   |      |      |      |     |
|                   |      |      |      |     |
|                   |      |      |      |     |
| 承受功率              |      |      | 30   | dBm |
| 工作温度              | -55  |      | +85  | °C  |
| 储存温度              | -55  |      | +125 | °C  |

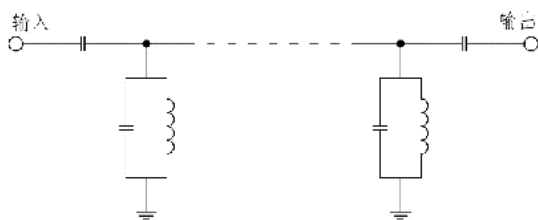
外形图: L: 6.5, W: 3.0, H: 0.254, 端口居中



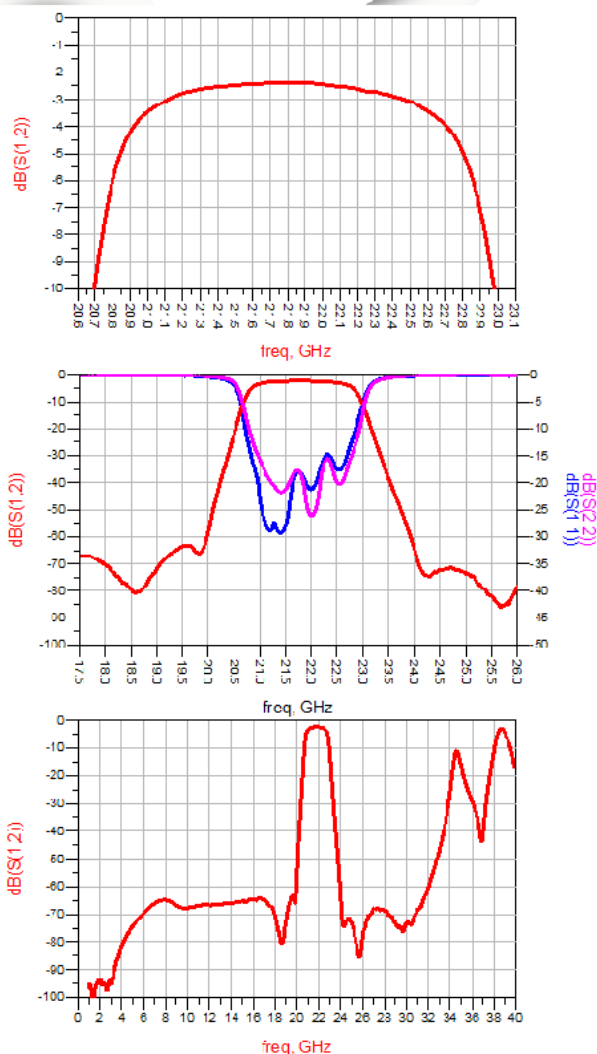
注意事项:

1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**1.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 ( $6.7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ )，载体厚度  $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配；

### 原理图



典型曲线,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



**Tel:18349127722**

**Fax:+86 28-80566718**

Email: pengxiaojun@cdsprs.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 [www.com-mw.com](http://www.com-mw.com)

商城 [www.dianzibuy.com](http://www.dianzibuy.com)

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。